

300mmウェハカセットレス洗浄装置

<概要>

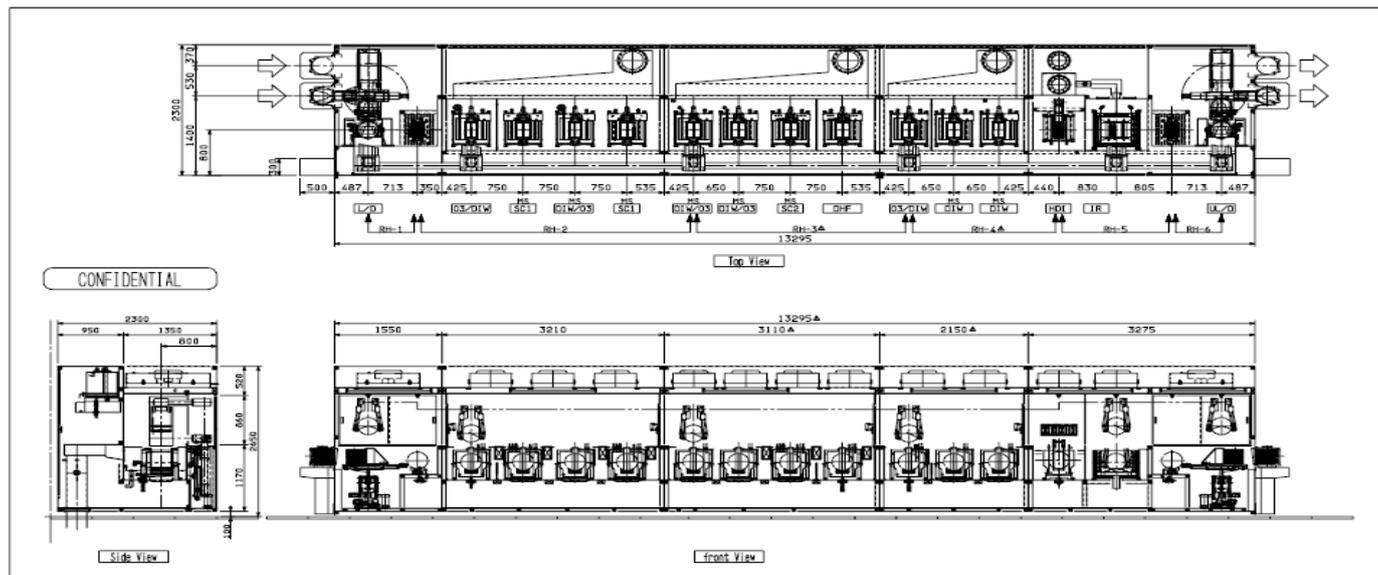
本装置はファイナルポリッシュ後の化学研磨工程で使用する装置です。特徴は 25 枚の Wf の隙間に 25 枚を入れハーフピッチにし 50 枚を一括処理します。65 μ m/5 個の高清浄度を達成しています。

構成：LD+03 水+SC-1+リンス+SC-2+HOTDI+IR乾燥+ULD

<主な仕様>

1. 被洗浄物 : 300mm 厚み 0.75 t
2. 処理方法 : カセットレスによる Dip 処理
3. 処理速度 : 50 枚/5min (可変)
4. 装置内清浄度 : 0.1 μ m クラス 1
5. パスライン : FL+900 \pm 5mm フープによる手動セット
6. 搬送方式 : 前面搬送

<外観図 (イメージ)>



(13300L×2300W×2650H)

<写真>



外観



洗浄槽